

附件 2、國科會參展之 22 個計畫團隊：

虛實加工技術開發與智能化系統整合專案計畫

序號	主持人	機關名稱	計畫名稱
1	蔡孟勳	國立臺灣大學機械工程學系暨研究所	結合邊緣運算與數位孿生之五軸工具機智能化技術研發
2	陳亮嘉	國立臺灣大學機械工程學系暨研究所	半導體先進封裝製程之線上智能化 AOI 關鍵檢測技術與虛實整合系統研發
3	覺文郁	國立臺灣大學機械工程學系暨研究所	開發動態數位雙生系統建立航太虛實工廠聚落
4	陳政雄	國立中興大學機械工程學系(所)	半導體材料超音波複合加工之智慧即時監控與遠端服務技術
5	蔡明祺	國立成功大學機械工程學系(所)	磁性元件積層製造之虛實加工整合技術開發
6	李明蒼	國立清華大學動力機械工程學系	高精度三維自由曲面光電半導體元件虛實複合加工技術及系統開發
7	陳世樂	國立中正大學機械工程學系	先進加減整合製造之虛實整合及技術深化

次世代智慧製造關鍵技術研發專案計畫

序號	主持人	機關名稱	計畫名稱
1	蔡孟勳	國立臺灣大學機械工程學系暨研究所	整合嵌入式 AI 晶片與先進 CNC 控制器之系統設計與研發
2	何昭慶	國立臺北科技大學製造科技研究所	以深度學習為基礎之深紫外光式三維矽穿孔臨場檢測模組

人機協作機器人技術開發與系統整合專案計畫

序號	主持人	機關名稱	計畫名稱
1	顏炳郎	國立臺灣大學生物機電工程學系	適應性多模態人機協同之手術機器人開發
2	藍兆杰	國立成功大學機械工程學系(所)	發展高動態阻抗反應之協作型機器人於人機智慧合作
3	張禎元	國立清華大學動力機械工程學系	基於人類技能移轉之雙手機器人應用於去毛邊技術

序號	主持人	機關名稱	計畫名稱
4	林柏廷	國立臺灣科技大學機械工程系	應用高精全場立體視覺暨異質感測融合於人員姿態預測及機械手臂路徑規劃之 5G-AI 人機共工技術
5	蕭俊祥	國立臺北科技大學機電整合研究所	人機協同工業機器手臂與無人車整合於鑄造件拋光研磨應用

發展智慧製造及半導體先進製程資安實測場域專案計畫

序號	主持人	機關名稱	計畫名稱
1	姚賀騰	國立中正大學先進工具機研究中心	具安全性異質工業物聯網之智慧製造系統場域建置與認證
2	李維楨	國立臺灣科技大學機械工程系	工業 4.0 智慧製造系統及工業物聯網平臺之資安技術開發與測試

智慧微塵感測器技術研發專案計畫

序號	主持人	機關名稱	計畫名稱
1	林鶴南	國立清華大學材料科學工程學系（所）	具互補式三晶片及智慧演算法之手機操控可攜式氣體感測器並應用於空氣品質監測
2	闕郁倫	國立清華大學材料科學工程學系（所）	以二維材料為基礎的 ppb 等級氣體感測元件與電路模組之開發及實際場域應用
3	洪瑞華	國立陽明交通大學電子研究所	應用於智慧城市之全方位系列氣體感測模組與智慧型雲端系統建置-應用於環境監測一氧化氮/二氧化氮系列氣體感測器開發
4	薛丁仁	國立高雄科技大學電機與資訊學院電子工程系(建工校區)	開發智慧城市應用之微型硫化氫氣體感測模組
5	蕭育仁	國立高雄科技大學智慧機電學院車輛工程系	下世代低能耗微機電半導體氣體感測器前瞻技術研發
6	陳峰志	財團法人國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心	智慧微塵感測器技術研發服務平台